

11. Fachsymposium Polymerverguss Anmeldung bis 15. September 2025

Termin und Ort der Veranstaltung

23./24. September 2025

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM

Wiener Straße 12

28359 Bremen

www.ifam.fraunhofer.de

Fragen zur Veranstaltung beantwortet

Julia-Katharina Thering

Telefon +49 421 2246-513

julia-katharina.thering@ifam.fraunhofer.de

Zimmerreservierung

Übernachtungsmöglichkeiten bestehen z. B. im Atlantic Hotel
Universum. Bitte reservieren Sie je nach Verfügbarkeit direkt im
Hotel unter dem Stichwort »Polymer«.



Anfahrtsbeschreibung

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM
Wiener Straße 12, 28359 Bremen
www.ifam.fraunhofer.de

Mit dem Auto:

- A27 bis Ausfahrt Horn-Lehe/Universität, Richtung Universität
- An der 1. Ampel rechts in den Hochschulring abbiegen
- Nach ca. 1 km an der 2. Ampel links in die Wiener Straße abbiegen

Mit der Bahn:

- Ab Bremer Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 6 bis Endhaltestelle »Universität Nord«

Mit dem Flugzeug:

- Ab Flughafen Bremen mit der Straßenbahnlinie 6 bis Endhaltestelle »Universität Nord«

Kontakt

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung IFAM
Wiener Straße 12
28359 Bremen
www.ifam.fraunhofer.de

© Fraunhofer IFAM

Anmeldung

Über den QR-Code erhalten
Sie Informationen zu den
Leistungen, der Teilnahme-
gebühr sowie die Möglichkeit
zur Online-Anmeldung.
Anmeldeschluss ist der
15. September 2025



Fraunhofer
IFAM

23./24. September 2025

11. Fachsymposium Polymerverguss

Vergussmassen und -prozesse

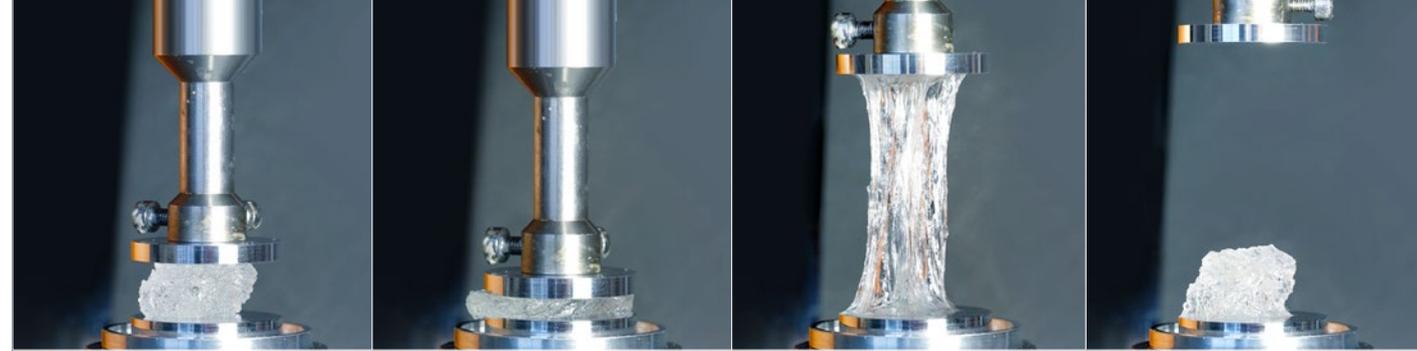
11. Fachsymposium Polymerverguss

Vergussmassen und -prozesse

Am 23./24. September 2025 richtet das Fraunhofer IFAM das 11. Fachsymposium Polymerverguss aus. Es findet in Präsenz am Fraunhofer IFAM in Bremen statt und richtet sich an erfahrene Anwendende in der Produktion, Entwicklung sowie Konstruktion. Das »Fachsymposium Polymerverguss« wird seit 2014 mit großem Erfolg und Zuspruch seitens der Teilnehmenden durchgeführt. In diesem Jahr wird das Schwerpunktthema »Vergussmassen und -prozesse« sein. Die zweitägige Tagung bietet Raum für vertiefende Diskussionen und Networking in angenehmer Atmosphäre.

Die steigende Anzahl elektronischer Baugruppen in sicherheitsrelevanten Anwendungen, z. B. in Kraftfahrzeugen und Sensoren, führen zu hohen Anforderungen hinsichtlich Langzeitstabilität und Funktionssicherheit. Durch Vergießen der Baugruppen mit einem Polymer werden die zu schützenden Bauteile komplett umschlossen, um ihre zuverlässige Funktionsweise zu sichern. Dabei ist ein Trend zu stetig steigenden Bauteilbeanspruchungen zu erkennen – z. B. durch Feuchte und andere Medien oder durch Temperatur(schock) wegen des Einbaus von Elektronik immer näher am Motor. Ebenso steigen die Anforderungen aufgrund von zunehmender Miniaturisierung mit steigender Leistungsdichte.

Anwendende benötigen für den erfolgreichen Einsatz ein grundlegendes Verständnis für die Materialien und wie diese im Prozess und der Herstellung zu handhaben sind. Ebenso ist es bedeutend, auf dem aktuellen Stand der Materialentwicklung zu sein. Daher stehen wichtige Trends im Bereich des Polymervergusses im Fokus des diesjährigen Fachsymposiums. Fachvorträge von ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Industrie beleuchten Themen wie Alterungsverhalten, die Materialbeständigkeit bei hohen Temperaturen und Feuchte im Automotive und Sensorik sowie rechtliche Aspekte des Materialeinsatzes.



Dienstag, 23. September 2025

11:00 Uhr [Beginn](#)

Begrüßung

[Dr. Martin Rütters, Fraunhofer IFAM](#)

Vergussmassen

Individualisierte Vergussmassen für verschiedenste Anwendungen und Branchen

Wettbewerbsvorteil durch maßgeschneiderte Produkte – Integration aktueller Markttrends – Kundenanforderungen im Fokus der Produktentwicklung
[Ferdinand Gerblinger, EPOXONIC GmbH](#)

Nächste Generation Elektronik Schutz mit Flood-Coating

Geringe Kosten – Geringes Gewicht – Konturenschärfe und Präzision
[Jens Bürger, ELANTAS Europe GmbH](#)

Schmelzharze (hotmelt molding) aus Anwendersicht: eine Stoffklasse mit großem Potenzial

1K-Verguss auf Polyolefinbasis – Verschiedene Vergusstechniken – Anlagen, Anwendungsbeispiele
[Jens-H. Klingel, KC-Produkte GmbH](#)

13:00–14:00 Uhr [Mittagspause](#)

Gießharze auf Flüssigkautschukbasis

Weich – Hydrophob – Silikonfrei
[Dr. Jan Olaf Schulenburg, ISO-ELEKTRA GmbH](#)

Rechtliche Aspekte

Mit Reach, POP und dem Omnibus in die Zukunft

Regelungen zu Deklarationspflichten und Beschränkungen von Stoffen: aktuelle Entwicklungen und Ausblicke
[Dr. Jens Nusser, Franßen & Nusser Rechtsanwälte PartGmbH / Dr. Berthold Liebig und Andre Hemmann \(Co-Autor\), ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG](#)

15:30–16:30 Uhr [Kaffeepause](#)

Vergussprozess

Simulation von thermisch leitfähigem Verguss mit hohem Füllgrad

Ermittlung der rheologischen Materialparameter – Simulation des Füllvorganges – Verifikation der Simulation
[Thomas Wolter, HELLA GmbH & Co. KGaA](#)

Effizientes Overmolding zum Schutz von Elektronik durch moderne duroplastische Formmassen

Verarbeitung – Nachhaltigkeit – Anwendungsbeispiele
[Markus Walcher, Raschig GmbH](#)

18:00 Uhr [Ende](#)

19:00 Uhr [Rundgang Bremer Innenstadt](#)

20:00 Uhr [Abendveranstaltung mit Diskussion: Anforderungen und Bedarfe der Industrie im Bereich Vergussmassen, rechtliche Aspekte und Vergussprozess](#)

Mittwoch, 24. September 2025

9:00 Uhr [Beginn](#)

Molding Technologien für Packages der Leistungselektronik

Transfer und Compression Molding – Anforderungen an das Verkapselungsmaterial – Beispiele für Einzelchip- und Modul-Packages
[Tina Thomas, Fraunhofer IZM](#)

Charakterisierung von Verkapselungswerkstoffen

Elektrochemische Impedanzspektroskopie – Moldwerkstoffe – Degradation
[Uta Gierth, Fraunhofer IKTS](#)

Re-Homogenisierung wärmeleitfähiger Medien in 200-Liter-Fässern

Problemstellung – Relevanz für den Prozess – Technische Lösung
[Tim Pröll, Atlas Copco EPS GmbH](#)

10:30–11:30 Uhr [Kaffeepause](#)

Alterung und Fehlerbilder

Alterung von Vergussmassen bei hochfrequenter rechteckförmiger Spannungsbelastung unter Temperatureinfluss

Thermische und elektrische Beanspruchung – Prüfmethode und Parameter – Charakterisierung unterschiedlicher Systeme von Vergussmassen
[Dipl.-Ing. Jan Christoph Kahlen, FGH e.V.](#)

Hohlräume im Lack: Fehleranfällige Elektronik?

Analytik – Simulation – Risikobewertung
[Pascal Steinforth, Fraunhofer IFAM](#)

Diskussion: Anforderungen und Bedarfe der Industrie im Bereich Alterung und Fehlerbilder

Abschlussdiskussion | Feedback – Weiterführung dieses Symposiums

13:00–14:00 Uhr [Möglichkeit zur Institutsbesichtigung](#)